CL

高速与网络连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

连接器外形尺寸

为 2 号壳体连接器的外形尺寸。

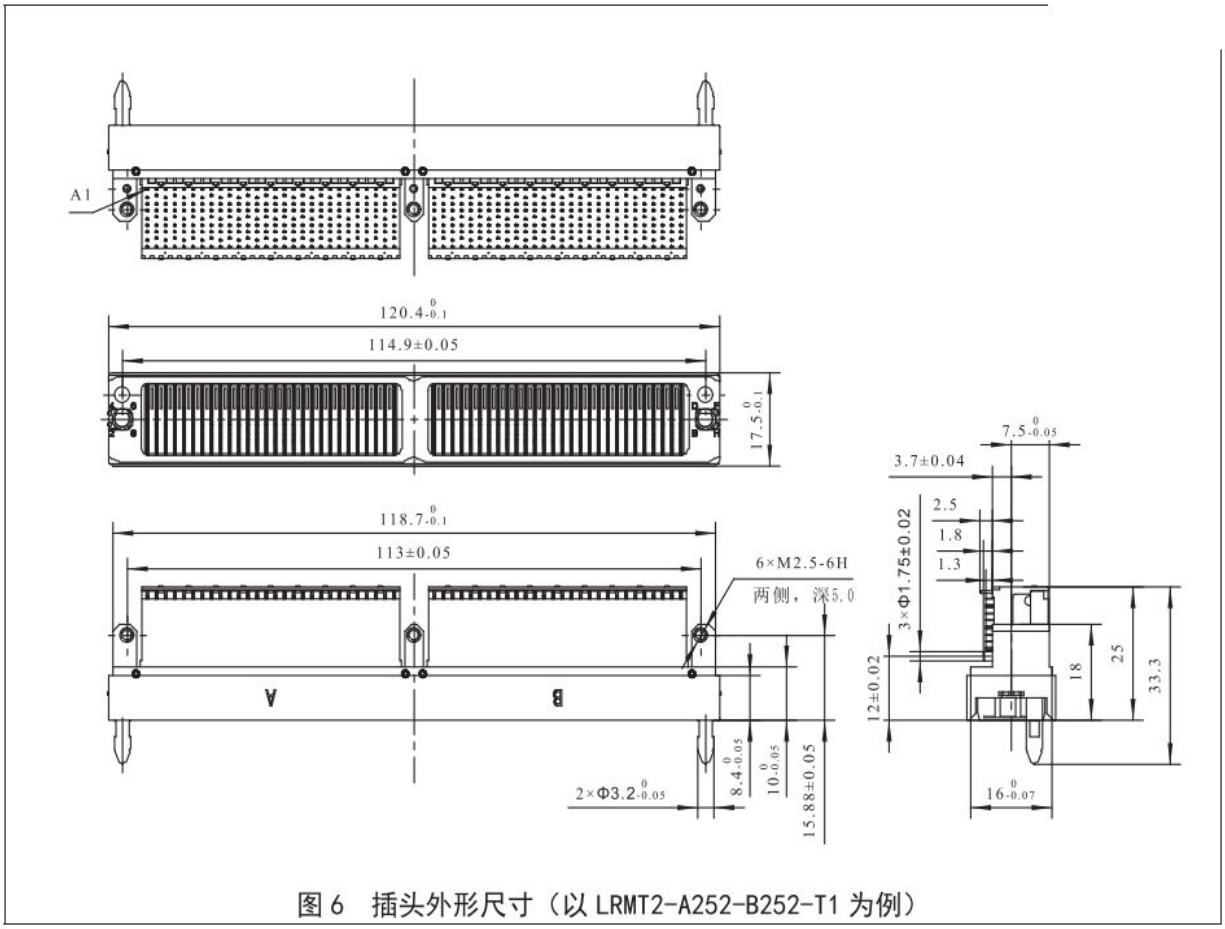


图 6　插头外形尺寸（以 LRMT2-A252-B252-T1 为例）

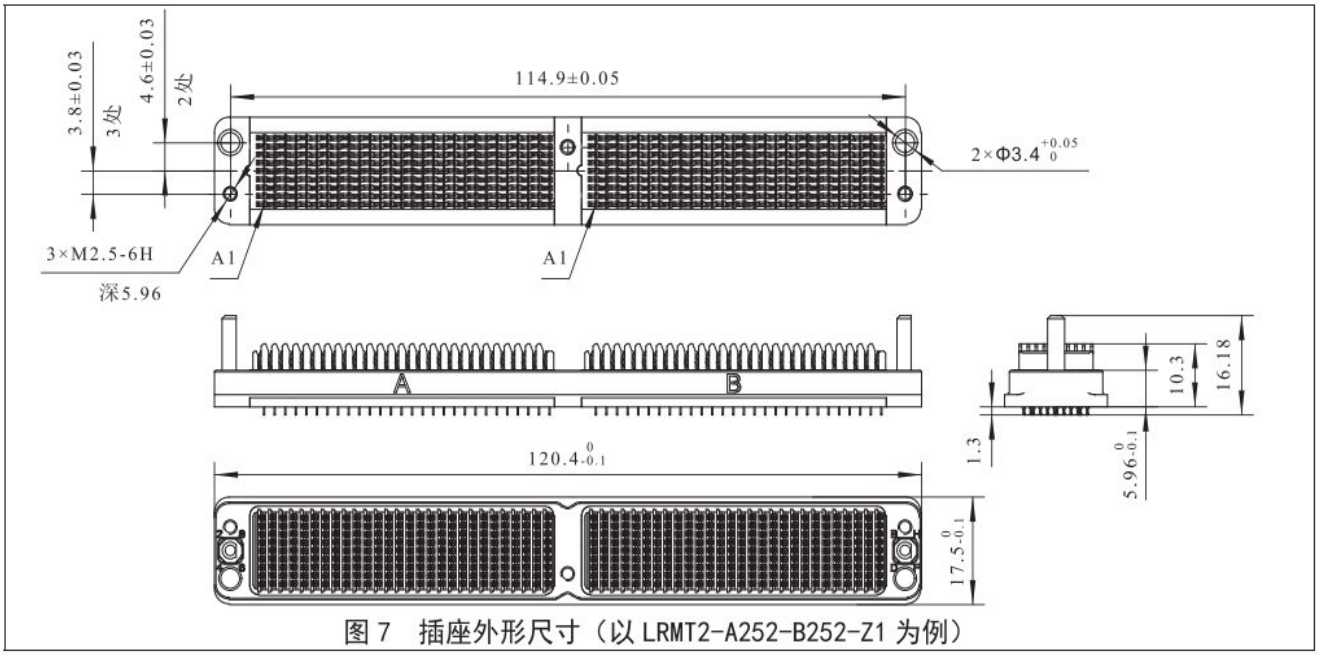


图 7　插座外形尺寸（以 LRMT2-A252-B252-Z1 为例）

典型型号连接器的推荐印制板开孔尺寸

为典型型号连接器的推荐印制板开孔尺寸。

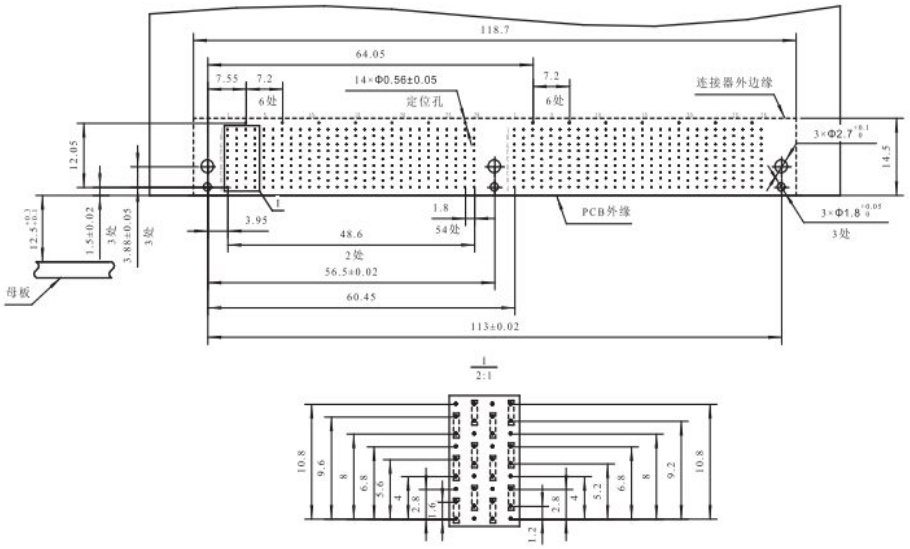


图 8　LRMT2-A252-B252-T1 的推荐印制板开孔尺寸

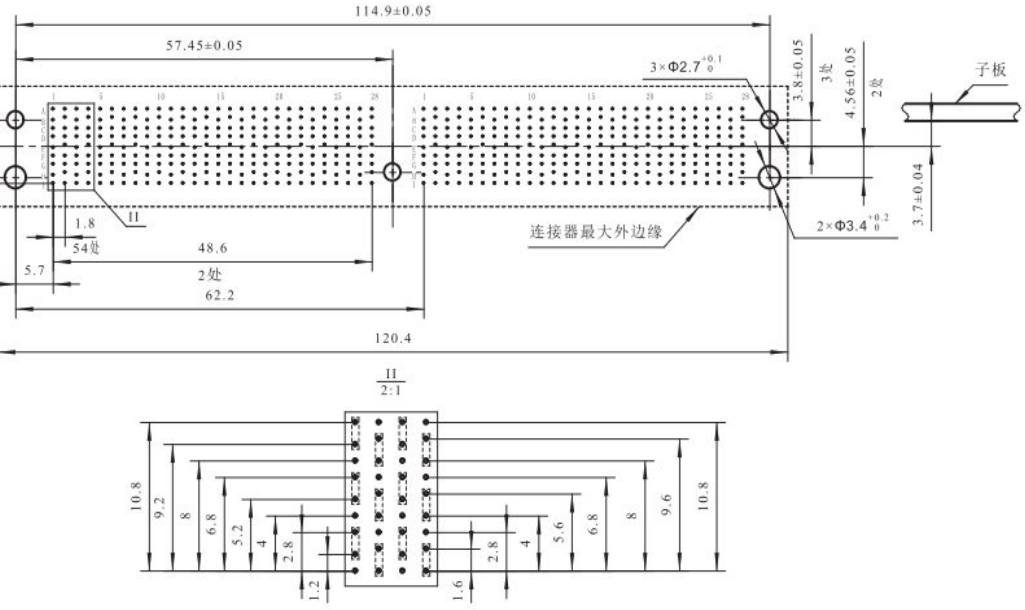


图 9　LRMT2-A252-B252-Z1 的推荐印制板开孔尺寸

PCB 设计布线建议

1.1 特性阻抗

设计确保线宽符合要求时，应考虑特性阻抗。

1.2 圆角

当在焊盘尺寸受到限制时，在迹线与焊盘的交接处需要圆角来改善焊盘环面积。

1.3 迹线居中

孔之间的所有迹线需居中以优化间距。

1.4 非功能焊盘

对于高速应用，应去掉非布线层焊盘（顶层和底层除外）。

1.5 表层走线

对于高速应用，不推荐表层走线。

2 工艺路线指南

2.1 LRMT 系列连接器差分对排布

连接器奇数列与偶数列的信号与地的布置形式不同，以第1列和第2列为例，信号与地的布置形式如图10所示。注意列号以具体连接器PCB封装要求为准，不以实际列位为准。由于每一列的地针是连通的，所以信号与地的布置形式必须按照本文档的规定进行定义，不得自行定义。



图10 连接器差分对排布

2.2 钻孔、成品孔、焊盘孔和反焊盘大小

钻孔、成品孔、焊盘孔和反焊盘大小如图11~图12所示，本文中未标注单位默认为mm。图中给定尺寸为建议尺寸，根据具体PCB板叠层的变化，可依据进行信号完整性仿真结果进行调整。

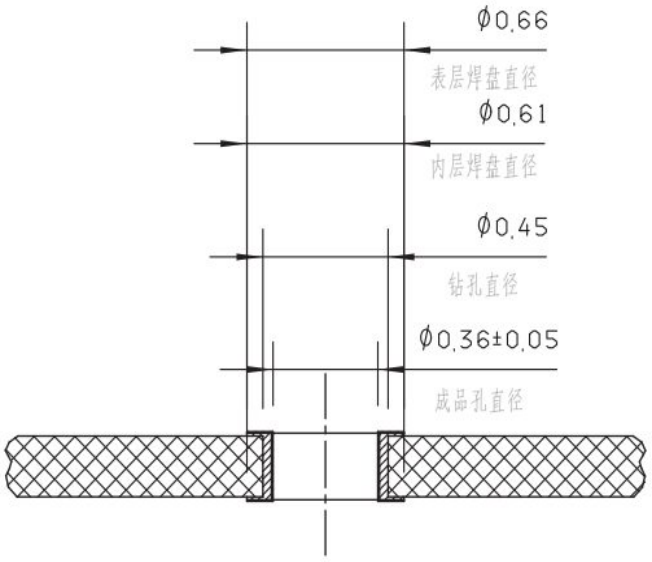


图11 子板和背板的钻孔后、成品孔和焊盘大小

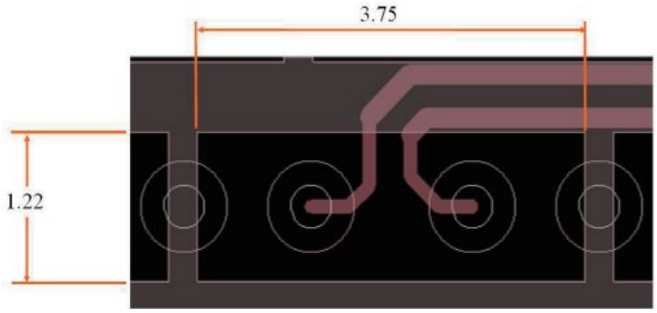


图12 背板和子板反焊盘大小

差分布线总宽度应小于反焊盘最小间隙，即图13中的尺寸A＜B。

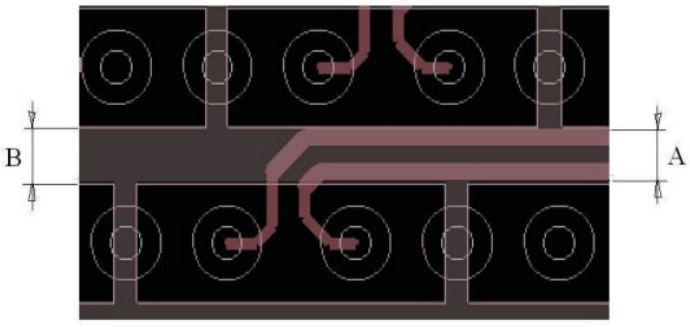


图13 高速差分布线示例

2.3 背钻

建议 PCB 使用背钻技术，来减小信号“stub”效应。

2.4 印制板长度补偿

连接器内差分对走线是等长的，PCB 上无需进行长度补偿。